

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-040

芯原微电子（上海）股份有限公司

关于新签订单的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、新签订单情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 29 日，芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）新签订单 82.40 亿元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《2026 年第一季度报告》。延续前期新签订单的强劲增长态势，公司 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 7 月 16 日新签订单进一步增长，达到 64.13 亿元。

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 16 日，公司新签订单合计 146.53 亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单，相关订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，芯片设计业务订单通常需 9-12 个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需 6-18 个月生产周期（即包含产能锁定与排产等待在内的完整生产交付周期），期间逐步实现收入转化。

前述 64.13 亿元新签订单中，AI 算力相关订单及数据处理领域订单占比均超过 90%。

二、相关说明及风险提示

上述新签订单数据为公司内部统计，未经审计，不能以此直接推算公司营业收入、净利润等财务数据。公司日常生产经营情况未发生重大变动，以上数据仅供投资者及时了解公司日常经营概况。公司业绩情况以公司最终披露的定期报告

为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日